

2026 年印尼半導體高峰會支持國家和全球協同合作，以加強半導體生態系統

駐印尼代表處教育組

在全球半導體供應鏈競爭日益激烈的背景下，印尼於 2026 年 1 月 29 至 30 日於萬隆舉辦 2026 年 Indonesia Semiconductor Summit (ISS 2026)。此次高峰會由 Indonesia Chip Design Collaborative Center (ICDeC) 主辦，匯集政府、大學、產業界和國際合作夥伴，旨在加強印尼的半導體生態系統及其與全球價值鏈的連結。

印尼高教科技部研發總局局長 Fauzan Adziman 作為主題演講嘉賓之一，強調了跨部門合作（政府、大學和產業）的重要性，此種合作有助於將研發與實際產業需求相結合，加速技術應用，並加強國家供應鏈。人才是半導體生態系統自主性和競爭力的關鍵，印尼擁有充沛的人力資源潛力（約 996 萬名學生、4,416 所大學/研究機構及 30 萬名教職員），學術的人才培養應更重視與產業需求相符的關鍵領域。

工業部長 Agus Gumiwang Kartasasmita 在啟動 2026 年國際半導體產業戰略議程時也表達了類似的觀點。他指出，半導體產業是決定供應鏈韌性和跨產業競爭力的策略性產業。政府正鼓勵從上游到下游加強半導體產業生態系統的基礎建設，包括發展設計能力、提升產業準備度、強化印尼在全球產業鏈中的地位。

印尼外交部副部長 Arif Havas Oegroseno 表示，半導體產業在全球佔據戰略地位，與地緣政治和技術競爭直接相關，國家半導體產業的發展並非一朝一夕，需要循序漸進，並將人才培養和晶片設計作為關鍵的基礎。他鼓勵印尼透過發展設計能力來鞏固自身地位，同時擴大國際合作，以增強人力資源能力並擴大對相關生態系統的支持。

ICDeC 主席 Trio Adiono 表示，印尼在半導體領域的三大主要資產：原物料、人才和市場，需要透過合作策略進行整合，以使印尼能夠更深入地融入全球價值鏈。

ISS 2026 也邀請了來自各合作夥伴和利害關係人的演講嘉賓，包括東協暨東亞經濟研究院（Economic Research Institute for ASEAN and

East Asia, ERIA)、亞洲發展銀行 (Asian Development Bank, ADB)。
此次會議為與會者提供了關於融資、供應鏈強化、人才培養、技術轉移以及加強半導體生態系統最佳實踐等方面的深刻見解。

撰稿人/譯稿人：駐印尼代表處教育組

資料來源：2026年1月31日 <https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/indonesia-semiconductor-summit-2026-dorong-sinergi-nasionalglobal-penguatan-ekosistem-semikonduktor>

